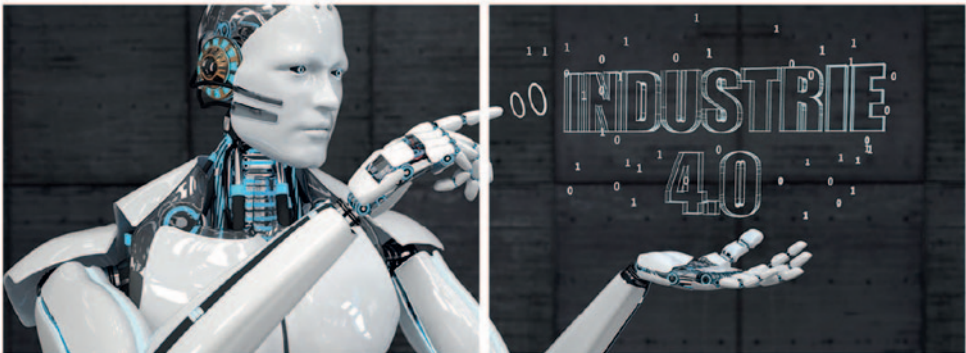




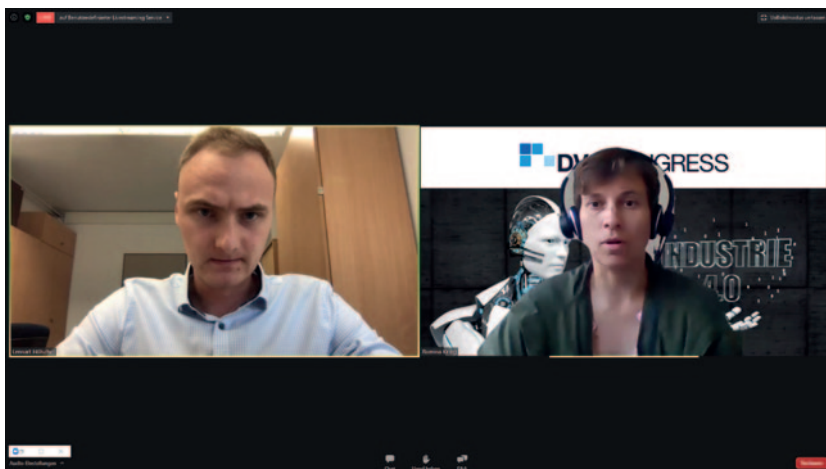

DVS CONGRESS



■ Erfolgreiche Online-Premiere für den DVS CONGRESS

Gut 320 Besucher trafen sich vom 14. bis 18. September 2020 erstmalig online zum DVS CONGRESS. Auch Teilnehmer aus Brasilien und den USA nahmen an dem umfangreichen Fachprogramm mit knapp 120 Vorträgen beispielsweise zu ‚Additive Fertigung‘, ‚Arbeitsschutz‘, ‚Moderne Schweißverfahren‘ und ‚Oberflächentechnik‘ teil. Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

zeigte sich als Veranstalter zufrieden mit dem Ablauf, dem Ergebnis und der durchweg positiven Resonanz. Innerhalb von nur zwei Monaten hatte der DVS zusammen mit seiner Beteiligungsgesellschaft DVS Media GmbH den jährlichen Kongress erstmalig online konzipiert und durchgeführt. Dass dies zu einem so gelungenen Ergebnis führte, ist auch den Referenten der Fachvorträge zu verdanken. Ohne die große Anzahl an Präsentationen hätte der DVS CONGRESS in dieser Form nicht stattfinden können.



Lennart Hölscher und Dr. Romina Krieg im Chat auf dem DVS Congress

Bild: Hölscher

Daher geht ein besonderer Dank des DVS an alle, die ihren Vortrag online aufbereitet und sich in einer Live-Schaltung den Fragen während der Veranstaltung gestellt haben.

Neben den Vorträgen und der Chat-Funktion standen ebenfalls ein Diskussionsforum sowie die Mög-

lichkeit der Vernetzung im Rahmen des DVS CONGRESS online zur Verfügung.

Der nächste DVS CONGRESS ist vom 14. bis 17. September 2021 in Essen geplant.

Ihre Ansprechpartnerin im DVS: Simone Weinreich,
T +49 211 1591-302, simone.weinreich@dvs-hg.de

■ Termine 2020

- 19. Nov. Sitzung der AG A2.7 ‚Kleben in Elektronik und Feinwerktechnik‘, Webkonferenz
- 23. Nov. Sitzung der AG V6.2 ‚Weichlöten‘, Webkonferenz
- 24. Nov. Sitzung Fachausschuss 10 ‚Mikroverbindungstechnik‘ der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS, Webkonferenz

■ Termine 2021

- 14.-17. Sept. DVS CONGRESS 2021, GST – Große Schweißtechnische Tagung, DVS Campus, Essen

■ Termine 2022

- 22./23. Feb. 11. DVS/GMM-Tagung ‚Elektronische Baugruppen und Leiterplatten – EBL 2022‘

■ DVS-Merkblätter zur Mikroverbindungstechnik

DVS 2612-1 (Ausgabedatum 2020-06) ‚Flussmittel für das Weichlöten in der Elektronik – Hinweise für den Praktiker‘

DVS 2612-2 (Ausgabed. 2020-09) ‚Flussmittel für das Weichlöten in der Elektronik – Reaktionsmechanismen, Reaktionsprodukte, Rückstände, Prüfmethode‘
DVS 2613 (Ausgabedatum 2018-05) ‚Temperaturprofiloptimierung beim Reflowlöten‘

DVS 2615 (Ausgabedatum 2015-12) ‚Verunreinigungen bleifreier Lotbäder‘

DVS 2809 (Ausgabedatum 1993-03) ‚Laserstrahlschweißen in Elektronik und Feinwerktechnik‘

DVS 2810 (Ausgabedatum 1992-09) ‚Drahtbonden‘

DVS 2811 (Ausgabedatum 2017-02) ‚Prüfverfahren für Drahtbondverbindungen‘

In Überarbeitung:

DVS 2616 ‚Flussmittelrückstände und ionische Verunreinigungen auf elektronischen Baugruppen‘

DVS 2950 ‚Widerstandsschweißen in der Elektronik und Feinwerktechnik – Übersicht und Grundlagen‘
 DVS 2951 ‚Widerstandsschweißen in der Elektronik und Feinwerktechnik – Zerstörende und zerstörungsfreie Prüfungen‘

■ Aktuelles aus der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS

Seit Beginn des Jahres anfinanzierte Forschungsvorhaben aus der Forschungsvereinigung:

- Nanolot – gradierte Nanoverbundwerkstoffe mit funktionsorientierten Eigenschaften zur Verarbeitung mit additiven Fertigungstechnologien
 Laufzeit: 1.02.2020 – 31.01.2022
 Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Elektro- und Informationstechnik, Professur für Mikrotechnologien
 Technische Universität Chemnitz, Institut für Füge- und Montagetechnik, Professur Schweißtechnik
- Substratangepasstes kombiniertes Laserstrahl- und -schweißen von elektrischen Leistungsverbindern für die Leistungselektronik
 Laufzeit vom 1.02.2020 bis 31.01.2022
 Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
- Geometrisch skalierte Spulen für das induktive Transient Liquid Phase (TLP)-Waferbonden in der Mikrosystemtechnik

Laufzeit vom 1.04.2020 bis 31.03.2022

Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Elektro- und Informationstechnik, Professur für Mikrotechnologien

Technische Universität Chemnitz Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse, Professur für Umformendes Formgeben und Fügen

- Optimierte reaktive Bondtechnologie auf Basis neuartiger Zirkonium-Systeme für den Einsatz in der Mikrosystemtechnik

Laufzeit ab 1.09.2020

Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH

Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V., Forschung + Entwicklung MST

Weitere Informationen zur Forschungsvereinigung erhalten Sie unter www.dvs-ev.de/fv



Der DVS-Verband ist Mitglied der *Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V.*



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.die-verbindungs-spezialisten.de



Handbuch der Leiterplattentechnik

Von K. Ritz und Autorenteam. Band 5, erste Auflage 2019 in zwei Büchern (Teil 1 und Teil 2) mit 1302 Abbildungen und ca. 1365 Seiten. ISBN 978-3-87480-355-7. Preis: 189,- EUR inkl. MwSt. zzgl. Verpackung und Versand.



Seit der letzten Auflage (Band 4) hat sich der Trend zur Digitalisierung und Miniaturisierung in allen Elektronikbereichen fortgesetzt. Erweiterte Anwendungen in den Bereichen Medizin, Automobil, Avionik und Industrieelektronik sind nicht ohne Auswirkung auf die Leiterplatte geblieben. Die geplante Neuauflage umfasst die Aktualisierung der Designmöglichkeiten, die erweiterte Beschreibung des Basismaterials,

deren Bestandteile und Eigenschaften, sowie die Herstellung der Schaltungen. Der allgemeine Trend: Einerseits „immer kleiner, feiner, höherlagiger“ und andererseits „immer größer für immer schnellere Elektronik“ hat Auswirkungen auf das Basismaterial und die Produktion (Galvano-, Laser- und Plasma- sowie Prüftechnik). Mehrere Sonderformen der Leiterplatte werden besprochen bzw. Aktualisiert.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 | D-88348 Bad Saulgau
 Tel. 07581/4801-0 | Fax 07581/4801-10
buchbestellung@leuze-verlag.de | www.leuze-verlag.de

